

出前型 半導体セミナー

設計から製造・評価までを一貫体験。講師派遣＋動画＋実測定の現地対面型セミナーです。



出前・対面型

講師が貴社に伺います。移動費・移動時間が不要で、大人数がまとめて受講できます。

動画による工程解説

クリーンルーム内の作業や装置の内部など、普段は立ち入れない製造現場を撮影した映像で工程の流れを追います。

設計・測定の実習

PCによるレイアウト設計実習と実機を用いた試作チップの測定実習。設計～製造～評価が一本につながります。



● コース概要

受講料

74,800円 / 2日制

99,800円 / 3日制

受講時間数

16時間 / 2日制

24時間 / 3日制

受講人数

20～100人

規模に応じて調整

対象者：企画・営業職、金融・電力関係などの非技術系者 / 大手半導体工場の生産系・ライン管理系技術職

● プログラム例（2日コース）

1日目 9:00～17:00

開会あいさつ・オリエンテーション

クリーンルーム入室の流れ／CMOSプロセス解説

Module 1-1/1-2 ゲートフォトリソ／Poly-Siエッチング

Module 2-1～2-3 アッシング／S/Dインプラ／RCA洗浄

Module 2-4 S/D活性化熱処理

Module 2-5 レイアウト設計演習

2日目 9:00～17:00

Module 3-1/3-2 酸化膜堆積／酸化膜エッチング（RIE）

Module 3-3/3-4 Al堆積／配線フォトリソ／シンタリング

Module 4-1 CMP（化学機械研磨）

Module 4-2 ダイシング／ワイヤーボンディング

Module 4-3 MOS／インバータ／リングオシレータの測定

Q&A・開会あいさつ

昨年度受講生満足度

4.68 / 5.0

昨年度受講者数

62名

受講生の声

「普段の製造現場では見られない部分を知ることができた」
「文系の自分でもチップ完成までの流れがイメージできた」

